



The DNA of tech.®

SOIC-8 封装 25 MBd 高速光耦

脉宽失真低至 6 ns、  
供电电流仅为 2 mA、  
工作温度高达 +110 °C



### 优点

SOIC-8 小型封装高速器件，配有数字输入输出接口，可简化设计并降低工业应用的成本

### 产品的主要特性

- ✓ CMOS 逻辑数字输入/输出接口
- ✓ 电压范围 2.7 V 至 5.5 V
- ✓ 最小瞬态共模噪声抑制 (CMTI) 达 20 kV/μs
- ✓ 与竞品解决方案引脚兼容，特别适合作新型和现有设计的替代器件
- ✓ 电流噪声隔离和断开接地环路，降低功耗的理想解决方案



### 资源



订购样品



产品页面



联系我们



信息图

### 市场和应用



#### 连接

- 通信固定基础设施



#### 消费电子

- 娱乐
- 电器



#### 移动

- 汽车电气化（动力总成）
- 交通



#### 能源

- 发电和勘探
- 分销和管理
- 存储



#### 工业

- 自动化、驱动器和工具
- 基础设施
- 家居和楼宇控制